



## マイクロン、NVIDIA Vera Rubin プラットフォーム向け HBM4、PCIe Gen6 SSD と SOCAMM2 の量産を開始

March 17, 2026 at 11:00 AM JST

### ニュースのハイライト:

- NVIDIA Vera Rubin向けHBM4 12層積層36GBの量産開始 – 2.8TB/秒<sup>\*1</sup>を上回る帯域幅と電力効率20%向上<sup>\*2</sup>を実現
- 業界初となるPCIe® Gen6 SSD製品の量産開始<sup>\*3</sup> – データセンター向けSSD製品「Micron 9650」は、Gen5と比較して最大2倍の読み取り性能とワット当たり性能100%向上<sup>\*4</sup>を実現し、NVIDIA® RVL (推奨ベンダーリスト)にNVIDIA Vera RubinおよびNVIDIA DGX™ プラットフォーム向けとして掲載、CMXを活用するエージェント型AIワークロードに最適化済み
- 192GB SOCAMM2の量産開始 – NVIDIA Vera Rubinプラットフォームで稼働するAIやHPCワークロードに対応し低消費電力・大容量メモリを拡充、SOCAMM2製品ポートフォリオの一部として48GB～256GBの幅広い容量で展開

2026年3月16日、米国カリフォルニア州サンノゼ — AI最適化されたメモリとストレージは、システム性能を加速させ、AIワークロードとインフラストラクチャーから実用的な価値を引き出す、戦略的アセットとなっています。Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU)は、HBM4 12層積層36GBの量産出荷を2026年第1四半期に開始しました。この製品は、NVIDIA Rubin GPU向けに設計されています。マイクロンは、HBM4の11Gbps超のピン速度<sup>\*5</sup>により、2.8TB/秒を超える帯域幅を実現しました。これはHBM3Eと比較して帯域幅は2.3倍、電力効率は20%以上向上<sup>\*2</sup>しています。

マイクロンは、HBMキューブ容量のさらなる拡大を見据えて、顧客へのHBM4 16層積層48GBのサンプルを出荷し、16ダイを積層するHBMの先進パッケージング技術を実証しました。これは、HBM4 12層積層36GBと比較して1スタックあたり容量を33%拡大する<sup>\*6</sup>、重要な成果です。

Micron Technology エグゼクティブVP 兼 最高事業責任者のスミット・サダナ (Sumit Sadana)は、「AIの次の時代を形づくるのは、エコシステム全体の共同エンジニアリングによる数々のイノベーション技術を通じ、緻密に統合されたプラットフォームです。マイクロンはNVIDIAとの緊密な協業により、コンピューティングとメモリが初期段階から一体となってスケールする設計を実現しました。その中核にあるのが、AIの原動力となり、これまでにない帯域幅・容量・電力効率を提供するマイクロンのHBM4です。このHBM4 12層積層36GBに加え、現在量産として業界初となるSOCAMM2とGen6 SSDからなるマイクロンのメモリおよびストレージは、NVIDIA Vera Rubinプラットフォーム全体にわたる中核基盤を形成し、次世代AIの可能性を最大限に引き出します」と述べています。

Micron SOCAMM2は、NVIDIA Rubin NVL72システムとスタンドアロン構成の[NVIDIA Vera CPU](#)プラットフォーム向けに設計され、CPUあたり最大2TBのメモリ容量と1.2TB/秒の帯域幅を実現します。

マイクロンは、PCIe Gen6対応データセンター向けSSDを量産する初の企業となりました<sup>\*3</sup>。Micron 9650 は、NVIDIA Vera Rubin NVL72関連のNVIDIA RVL (推奨ベンダーリスト)に掲載され、すでにDGX™ Vera Rubin NVL72とDGX Rubin NVL8での認定評価が進められています。電力効率を重視し液冷環境に最適化されたMicron 9650は、AIの学習処理、推論、NVIDIA Context Memory Extension (CMX)などのワークロードに高速かつ低レイテンシーのデータアクセスを提供し、最大28GB/秒のシーケンシャル読み取りスループットとランダム読み取り550万IOPSを実現します。さらに、Micron 7600とMicron 9550もNVIDIA Vera Rubin NVL72対応のNVIDIA RVLに追加され、PCIe Gen5 SSD製品として、アーキテクチャー設計の選択肢を広げます。

### マイクロンのイノベーション技術をNVIDIA GTC 2026で紹介

マイクロンは、NVIDIAが主催するGPUカンファレンス「NVIDIA GTC 2026」で、データセンターからエッジまでエンドツーエンドのAIアクセラレーションを実現する、最先端のメ

メモリ&ストレージ製品ポートフォリオをマイクロンブース(ブース1407)で紹介します。

関連リソース:

- [マイクロンのAIデータセンター製品ソリューション](#)
  - [Micron HBM4画像ギャラリー](#)
  - [Micron 9650 PCIe Gen6画像ギャラリー](#)
  - [From breakthrough demo to deployment path: SCADA on production-grade PCIe Gen6 hardware at NVIDIA GTC 2026](#)
- \* 1 同一容量および積層数(36GB 12H)における、HBM4と前世代のHBM3Eとの帯域幅の比較
- \* 2 HBMの電力効率の比較: (HBM4 12H vs HBM3E 12H、9.2Gbps動作時、ワークロードパターン 60/30/10/75)【社内の電力計算ツールに基づく】
- \* 3 2026年2月12日、マイクロンは9650 SSDの量産を[発表しました]。Forward Insights社のアナリストレポート「SSDサプライヤー状況 2025年第4四半期」(2025年11月発行)によると、このブログの公開時点で、売上高上位5社のOEMデータセンター向けSSDサプライヤーの中で、Gen6 SSDの量産を発表している企業は他にありませんでした。
- \* 4 Micron 9650 SSDの性能結果については、[\[Micron 9650 SSD 製品概要\]](#)の表1を参照してください。
- \* 5 マイクロンの社内テストおよび機密顧客のテスト手段での検証に基づきます。
- \* 6 HBM4 36GB 12HとHBM4 48GB 16Hの容量を比較した場合、48GBキューブはHBM実装あたりの容量が33%増加

#### Micron Technology, Inc.について

マイクロンは、情報のあり方を変革し、すべての人々の生活を豊かにするために、革新的なメモリおよびストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。顧客第一主義を貫き、テクノロジーの最前線でリーダーシップを発揮し続け、洗練された製造技術と事業運営を妥協なく追及するマイクロンの製品ポートフォリオは、DRAM、NAND、NORの各種メモリからストレージ製品まで多岐にわたり、高性能な製品を多数展開しています。マイクロンで生まれた数々のイノベーションは、データの活用を加速すると同時に、人工知能(AI)や計算集約型アプリケーションといった最先端分野の進歩の基盤として、データセンターからインテリジェントエッジまで、さまざまな事業機会を新たに生み出し続けています。Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU)に関する詳細は、[micron.com](#)をご覧ください。

© 2025 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品、仕様は予告なく変更されることがあります。マイクロン、マイクロンのロゴ、およびその他のすべてのマイクロンの商標はMicron Technology, Inc.に帰属します。他のすべての商標はそれぞれの権利者に帰属します。